

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2018-006

天水华天科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 2,131,112,944 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常文瑛	杨彩萍	
办公地址	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号	甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号	
电话	0938-8631816	0938-8631990	
电子信箱	htcwy2000@163.com	caiping.yang@ht-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

报告期，公司的主营业务为半导体集成电路封装测试，目前公司集成电路封装产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM (MCP)、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-out 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。

公司为专业的集成电路封装测试代工企业，主要经营模式为根据客户要求及行业技术标准和规范，为客户提供专业的集成电路封装测试服务。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

2017 年度，公司营业收入和利润增长的驱动因素主要为公司封装规模的快速扩大和客户订单的不断增加以及先进封装产能的不断释放。

（二）公司所属行业情况

公司所属行业为集成电路行业，集成电路行业因其技术复杂，产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。公司为国内领先的集成电路封装测试企业，目前在中国天水、西安、上海、昆山、深圳及美国凤凰城设立了产业基地，产业规模位列全球集成电路封测行业前十大之列。

从集成电路产业发展的历史情况来看，集成电路市场具有一定的周期性，但近几年来，随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的不断提高，其与全球经济增长的联动性有所增强，行业自身的周期性特征逐渐弱化，未来增长率的变化将趋向平稳，更多表现出小幅波动的特征。

根据世界半导体贸易统计组织统计，2017 年世界半导体产业销售收入达到了 4086.91 亿美元，同比增长 20.6%，首破 4000 亿美元大关，增长速度创自 2011 年以来新高。同时，半导体企业之间的整合并购热度较前几年有所降低，但强强联合、跨界融合成为新的发展趋势，使得半导体产业集中度进一步提高，市场竞争更加激烈。

2017 年受市场需求驱动，以及政策与资本的有力支持，我国集成电路产业发展速度仍领先于全球半导体产业，继续保持了强劲增长势头。根据中国半导体行业协会统计，2017 年我国集成电路产业销售额达到 5411.3 亿元，同比增长 24.8%。其中，设计业受各类智能终端、物联网、汽车电子以及工业控制领域的强劲需求带动，实现销售额 2073.5 亿元，同比增长 26.1%；国家和各地的集成电路投资基金的逐步投入以及多条集成电路制造线的建设和扩产，使制造业成为三业中增速最快的产业，同比增长 28.5%，销售额达到 1448.1 亿元；封装企业规模的快速扩大、客户订单的不断增加以及先进封装产能的不断释放，推动封测业完成销售额 1889.7 亿元，增速达到 20.8%。2017 年我国集成电路的设计水平、制造能力与国际先进之间的差距进一步缩小，先进封装测试技术接近或达到国际先进水平。

2017 年我国集成电路产业虽然发展速度迅速，但由于市场需求庞大，并且受国内设计技术以及制造工艺和产能的限制，我国集成电路仍然主要依赖进口。根据海关统计，2017 年我国进口集成电路 3770 亿块，同比增长 10.1%，进口金额 2601.4 亿美元，同比增长 14.6%；出口集成电路 2043.5 亿块，同比增长 13.1%，出口金额 668.8 亿美元，同比增长 9.8%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	7,009,887,112.79	5,475,027,849.36	28.03%	3,874,017,127.37
归属于上市公司股东的净利润	495,169,978.15	390,920,674.34	26.67%	318,516,127.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	423,416,413.07	341,040,999.19	24.15%	211,215,485.05
经营活动产生的现金流量净额	903,535,927.95	862,521,250.89	4.76%	683,548,570.90
基本每股收益（元/股）	0.2324	0.1834	26.72%	0.1495
稀释每股收益（元/股）	0.2324	0.1834	26.72%	0.1495
加权平均净资产收益率	9.67%	8.19%	1.48%	11.76%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	9,366,444,197.41	7,677,244,075.28	22.00%	7,068,713,474.97
归属于上市公司股东的净资产	5,346,960,275.79	4,908,081,903.96	8.94%	4,648,763,471.43

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,485,799,873.44	1,826,510,825.35	2,011,452,186.64	1,686,124,227.36
归属于上市公司股东的净利润	114,474,064.98	140,518,949.73	132,701,287.29	107,475,676.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,829,043.56	132,298,418.72	110,756,454.52	72,532,496.27
经营活动产生的现金流量净额	161,215,968.06	325,696,498.87	116,097,957.15	300,525,503.87

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

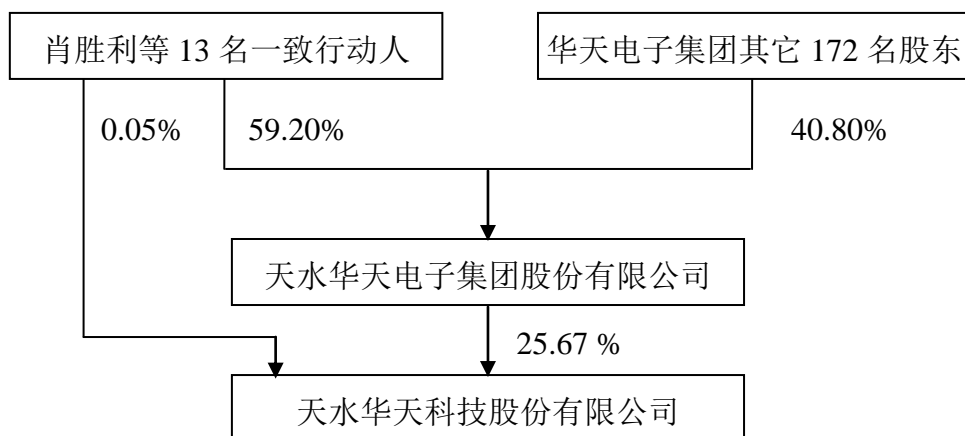
报告期末普通股股东总数	107,494	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	101,945	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有法人	25.67%	547,150,806	0	质押	63,775,422	
招商财富—招商银行—汇垠天粤 1 号专项资产管理计划	其他	1.40%	29,819,550	0			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001 深	其他	0.90%	19,142,244	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	17,278,717	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	16,314,740	0			
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	其他	0.76%	16,093,141	0			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	15,352,725	0			
前海人寿保险股份有限公司—海利年年	其他	0.66%	13,999,988	0			
中国银行股份有限公司—前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61%	12,924,840	0			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.56%	11,878,598	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	报告期末,申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 27,656,757 股股份,占公司总股份的 1.30%;华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 26,181,791 股股份,占公司总股份的 1.23%;中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 23,155,933 股股份,占公司总股份的 1.09%;国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 18,843,396 股股份,占公司总股份的 0.88%;广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,644,860 股股份,占公司总股份的 0.83%;国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 17,604,320 股股份,占公司总股份的 0.83%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后,前 10 名股东情况如上表所示。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 概述

2017 年全球经济的持续向好，促进了全球半导体产业的稳定快速发展。我国集成电路产业在消费电子和计算机等传统应用领域需求进一步增长，以及云计算、物联网、大数据等战略性新兴产业快速发展的拉动下，市场需求持续发力增长。2017 年公司紧贴集成电路市场发展，通过不断开发和完善客户结构，持续研发先进封装技术，大力推进募集资金投资项目的实施，促进了公司的快速发展，顺利完成了预期目标。

2017 年公司共完成集成电路封装量 282.50 亿只，同比增长 35.75%，晶圆级集成电路封装量 48 万片，同比增长 27.30%，实现营业收入 70.10 亿元，同比增长 28.03%，营业利润 6.29 亿元，同比增长 52.00%。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 93.66 亿元，同比增长 22.00%，归属于上市公司股东的净资产 53.47 亿元，同比增长 8.94%。2017 年公司主要工作开展情况如下：

①大力实施募集资金投资项目，进一步提升先进封装测试产能。

全面完成了“集成电路高密度封装扩大规模”、“智能移动终端集成电路封装产业化”、“晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化”三个募集资金投资项目建设。截止 2017 年

底，三个募集资金投资项目投资进度分别达到 99.13%、101.04%和 92.94%，项目累计实现效益 2.09 亿元。

②继续发挥销售龙头作用，努力增强市场开发能力。

以重点客户为目标，充分发挥销售和科研团队人员的共同力量，切实提高市场开发能力。2017 年公司在优化调整客户结构的同时，加大市场开发力度，新开发有潜力国内客户 20 多家；稳步推进国际市场开发工作，成功引进 ST、On-Semi、NEXPERIA、SEMTECH、TOSHIBA、LAPIS、ROHM、PANASONIC 等多家国际知名客户，台湾地区前十大设计企业中已有六家与公司实现了合作。

③不断开发先进封装技术，持续增强科技创新能力。

公司自主研发开发的硅基晶圆级扇外型封装技术取得了标志性成果，实现了多芯片和三维高密度系统集成。公司与苏州日月成科技有限公司利用硅基晶圆级扇外型技术联合开发的 LED 显示屏控制芯片系统级封装产品已进入小批量生产阶段。完成了 0.25mm 超薄指纹产品封装工艺开发，开发了心率传感器、高度计及 ARM 磁传感器等 MEMS 产品并成功实现量产。

本年度内公司共获得国内授权专利 63 项，其中发明专利 18 项；“密节距小焊盘铜线键合双 IC 芯片堆叠封装件及其制备方法”发明专利获第十九届中国专利优秀奖；“基于引线框架的小外形倒装封装技术”和“硅基晶圆级扇外型封装技术”荣获“第十二届（2017 年度）中国半导体创新产品和技术”；华天商标在美国注册成功。

④积极实施信息化建设项目，努力提高客户服务水平。

结合客户需求和公司发展需要，2017 年公司按照系统规划、分步实施的原则，有层次分步实施的实施了信息化建设项目。通过一年时间的投资建设，基本完成了信息化建设项目一期任务，SAP 系统在华天科技、华天西安两地的上线测试和试运行，成功启动 MES 项目上线，实现了移动审批和无纸化办公。信息化建设项目的及时推进，促进了公司各种资源的高效配置，不断提高了工作质量和效率以及客户服务能力。

⑤加大股权投资力度，促进公司快速发展。

2017 年公司投资 449 万美元，取得从事人工智能芯片设计企业 Gyrfalcon Technology Inc. 7.89%的股权。依托下属企业西安天利的投资平台，与一村资本有限公司合作设立产业基金，重点关注半导体产业相关领域，积极寻找新的增长点和投资并购标的。

(2) 主营业务分析

①营业收入构成

单位：元

	2017年		2016年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,009,887,112.79	100%	5,475,027,849.36	100%	28.03%
分行业					
集成电路	6,886,745,506.59	98.24%	5,330,071,050.46	97.35%	29.21%
LED	123,141,606.20	1.76%	144,956,798.90	2.65%	-15.05%

分产品					
集成电路	6,886,745,506.59	98.24%	5,330,071,050.46	97.35%	29.21%
LED	123,141,606.20	1.76%	144,956,798.90	2.65%	-15.05%
分地区					
国内销售	2,652,617,184.93	37.84%	2,101,167,988.81	38.38%	26.24%
国外销售	4,357,269,927.86	62.16%	3,373,859,860.55	61.62%	29.15%

②营业成本构成

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成电路	6,886,745,506.59	5,634,405,088.01	18.18%	29.21%	29.63%	-0.27%
LED	123,141,606.20	120,954,826.42	1.78%	-15.05%	-13.91%	-1.29%

③产量、销量情况

行业分类	项目	单位	2017年	2016年	同比增减
集成电路	销售量	万只	2,789,595	2,037,254	36.93%
	生产量	万只	2,824,995	2,081,102	35.75%
	库存量	万只	98,384	62,984	56.21%
集成电路	销售量	片	473,819	384,587	23.20%
	生产量	片	479,980	377,049	27.30%
	库存量	片	9,862	3,701	166.47%
LED	销售量	万只	364,558	478,638	-23.83%
	生产量	万只	363,044	489,310	-25.80%
	库存量	万只	39,245	40,759	-3.71%

变动原因分析：主要为募集资金投资项目产能逐步释放和客户订单增加，使得集成电路封装产量较上年同期大幅增加。

(3) 下一年度经营计划

根据行业特点和市场预测，2018年度公司生产经营目标为全年实现营业收入80亿元，生产经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

2018年主要开展以下工作：

①坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的管理理念，加强服务国际客户和目标客户开发及导入能力，加快公司市场份额的有效拓展。

②完善制度建设，抓好基础管理，不断提高质量、管理和技术创新水平，全面提升企业的综合竞争能力。

③根据市场需求，扩大FC、Fan-out、Bumping、WLP等先进封测生产能力，提高先进封测占比，夯实产业发展基础；紧盯产业技术发展趋势和封装技术需求，重点关注AI、5G、物联网、大数据、云计算等应用领域的发展，开发先进封测技术和产品，保持行业技术领先优势。

④继续开展人才梯队建设。通过外部积极引进、内部加强培训，优化绩效考核，完善激

励机制等措施，打造一支结构合理、储备充足的员工队伍，满足公司规模化、国际化发展的人才需求。

⑤加快信息化建设项目进程，积极推进集成电路封装测试生产线自动化和智能化升级改造，进一步提高生产效率和生产能力。

（4）未来面对的风险因素分析

① 受半导体行业景气状况影响的风险

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，公司经营状况与半导体行业的景气状况紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。另外，随着集成电路封装测试行业的竞争越来越激烈，也将加大公司的经营难度。

② 产品生产成本上升的风险

公司产品主要原材料价格的波动会导致公司经营业绩出现一定的波动。同时，随着近几年人力成本的持续上升，给公司的成本控制造成一定压力。

针对上述风险，公司未来将继续优化生产工艺流程，加大工艺升级力度，提高设备利用率；强化节能降耗和材料消耗管理，降低经营成本；提高生产自动化、信息化水平，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

③ 技术研发与新产品开发失败的风险

集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快技术研发和新产品开发步伐，如果公司技术研发能力和开发的新产品不能够满足市场和客户的需求，公司将面临技术研发和新产品开发失败的风险。

针对上述风险，公司未来将紧跟半导体行业技术发展趋势，及时了解和深入分析市场发展热点和用户需求的变化，加大集成电路先进封装技术的研发和产业化，分散和化解市场及研发风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成电路	6,886,745,506.59	651,477,903.24	18.18%	29.21%	51.26%	-0.27%
LED	123,141,606.20	-22,304,079.23	1.78%	-15.05%	-33.13%	-1.29%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

①本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，此项会计政策变更采用未来适用法处理。

②本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以及非货币性资产交换利得和损失变更列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 828,369.77 元，营业外支出 2,902,558.43 元，调减资产处置收益 2,074,188.66 元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期，全资子公司华天包装持有天水华天合汽车销售服务有限公司的股权由 60%下降至 20%，本公司境外下属子公司 FCI 的子公司 FlipChip International GMBH 注销，因此，上述两个公司不再纳入公司合并报表范围。

天水华天合汽车销售服务有限公司 2016 年 9 月成立，业务量较小，FlipChip

International GMBH 无实际业务，本报告期合并报表范围的变化对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一八年三月二十七日